



LOTPASTE SC BLF 081

Typ ISO 1.2.3.C

Die Lotpaste **SOLDER CHEMISTRY BLF081** ist eine Weiterentwicklung im Hinblick auf alle sogenannten **bleifreien SMT-Anwendungen** und dem Kundenwunsch nach einer leichter druckbaren und sehr lange klebender Paste, um die langen Stillzeiten zwischen Drucken und Bestücken überbrücken zu können. Dabei soll unserer „Markenzeichen“ d.h. minimale Rückstände auf PCB, die dicht an der Lötstelle nach dem Löten verbleiben, behalten werden.. Die Verwendung von neusten Typen von modifizierten Kunststoffen und Rheologiezusätzen bei der Lotpaste und die daraus resultierende, sehr gute Kombinationsmöglichkeit mit bleifreien Legierungen, sowie die neuesten Erkenntnisse in der SMT haben zu dieser Weiterentwicklung beigetragen. Eine sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC- und MIL-Normen lag auch ihr selbstverständlich zugrunde.

Die **BLF081** ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem **bleifreien Lotpulver**, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf **Kunstharzbasis, das der Kl. RE L0 nach ISO9453 absolut halogenfrei und damit übertrifft die DIN EN61190-1-1.**

Die üblichen Vorteile, wie die hervorragende Konturenstabilität, keine Lotkugel- oder Spritzerbildung, sowie hohe Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste, neben einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und exzellenter Standzeit, folgende Vorteile aus:

- * **BLF081*** Exzellente Resistenz gegen Feuchtigkeit. Extrem lange Klebrigkeit!!!
- * **BLF081*** Bildet sehr homogene, lunkerfreie Lötstellen!
- * **BLF081*** Lötet hervorragend, auch auf leicht korrodierten Oberflächen.
- * **BLF081*** Eine hervorragende, stundenlange Druckqualität, wie bereits gewohnt!
- * **BLF081*** Hinterlässt natürlich keine teerartigen Rückstände in der Lötanlage.
- * **BLF081*** Die Rückstände sind kaum vorhanden und wasserklar.

PHYSIKALISCHE DATEN

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	<u>Schmelzpunkt</u>	Gemäß Internationalem Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen:	
Sn96,5/Ag3,5	221°C		
Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7	219°C	Kl.3	25 – 45 µm
Sn96,9/Ag2,6/Cu0,5	217-221°C	Kl.4	20 – 38 µm
Sn96,5/Ag3/Cu0,5	217-219°C	Kl.5	10 – 25 µm
Sn99,3/Cu0,7	227°C		

VIKOSITÄT (Pa.S) ± 10% gemessen nach Brookfield RVT–DV II Viskosimeter mit 88% Metallgehalt:

<u>Viskosität:*</u>		Konturenstabilität – DIN 32513		Solderballing nach IPC	Benetzung nach IPC
		Sofort	20min 80°C		
700 Pas	Pulverklasse III	Kl.1 = 0,2	0,2	1	1
780 Pas	Pulverklasse IV	Kl.2 = 0,2	0,3		

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messung am	4.Tag	<u>21.Tag</u>
	$2,6 \times 10^{11}$	$2,8 \times 10^{11}$

QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste **BLF081** ist eine RMA-Paste, die den Anforderungen der MIL-QQ-S571e entspricht. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung (nach DIN 32513) wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen **halogenfrei**, der RE L0 entsprechende, Rückstände, die auf der Leiterplatte verbleiben können.

VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst dicht verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozeß darf selbstverständlich neue Paste der älteren zur Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15 – 100 mm/s.

Merke! Der Pastendrucker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in der Linie.
Das Wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 88% Metallgehalt empfohlen.

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen.

Wir empfehlen daher den SC Schablonenreiniger. Die Lotpaste ist mit allen gängigen Reflow-Systemen aufschmelzbar.

LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde – Dosen(!) bei ca. 20°C (RT): 6 Monate

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird. **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!**

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste:

<u>Legende</u>	<u>Pastentyp</u>	<u>Legierung</u>	<u>Korngröße</u>	<u>Flussmittelanteil</u>	<u>Gebindegröße</u>
z.B.	BLF081	96,5/Ag3/Cu0,5	T4	12%	500g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste (SC...) L-Sn96,5Ag3Cu0,5 / 1.2.3.C / 88 - 3 500g (Gebinde)

IAM Solder Chemistry GmbH ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut

Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020

e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.